

## 合晶科技公司招生說明會

## Wafer Works Company Intro

人力資源處

2024/5/15

- 0  
1 合晶市場放眼全球 人才紮根台灣  
**Vision**
- 0  
2 公司簡介  
**Company Introduction**
- 0  
3 內部需求(職缺與技能)  
**Job Requirements & Specifications**

**THE CUSTOMER-CENTERED**  
SOLUTION PROVIDER  
OF SEMICONDUCTOR MATERIALS  
-CUSTOMIZED WAFER SERVICE-



Epitaxial Wafer



SOI Wafer



Polished Wafer



Customized Wafer



## Vision

To become the  
customer - centered  
solution provider of  
semiconductor  
materials

以客為本  
的半導體材料供應商

**THE CUSTOMER-CENTERED**  
SOLUTION PROVIDER  
OF SEMICONDUCTOR MATERIALS  
-CUSTOMIZED WAFER SERVICE-



Epitaxial Wafer



SOI Wafer



Polished Wafer



Customized Wafer

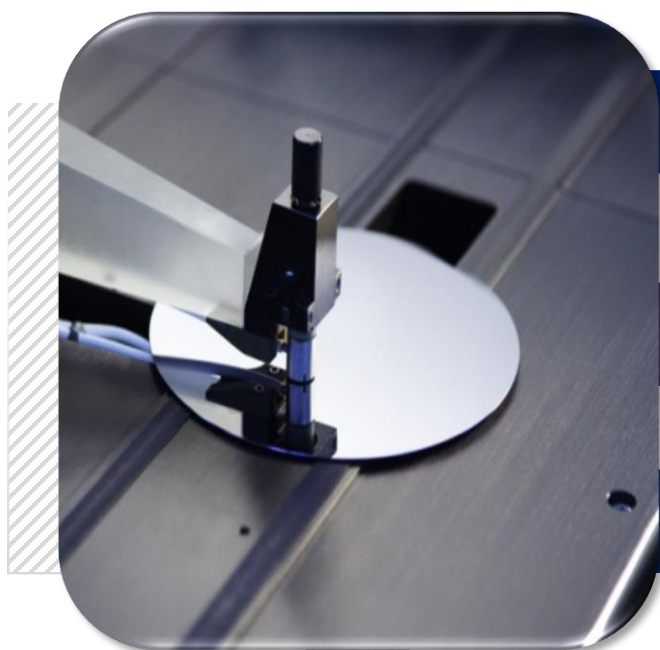


# 合晶科技



**1** 家公司  
個產品  
one company, one product  
內部凝聚共識 → 邁向成功

# 合晶集團綜覽



Established

1997年7月設立；2002年5月上市

Products

Semiconductor-graded silicon wafers  
(拋光晶圓、磊晶晶圓、雙拋晶圓、研磨晶圓、  
蝕刻晶圓、超薄晶圓及 SOI 晶圓)

# of employees

1,074 (台灣) / 2,068 (全球)

Position

全球第六大矽晶圓材料供應商

全球前三大低阻重摻矽晶圓材料供應商

# 合晶集團全球據點與生產能力



- 集團總部/生產/銷售
- 銷售



## Epi Wafer

Single Layer (mm): 150 / 200 / 300  
 Dual Layer (mm): 150 / 200 / 300  
 Multi Layer (mm): 150 / 200 / 300  
 Buried Layer Service (mm): 200 / 300

## Polished Wafer

Dopant: B / P / As / Sb  
 Orientation: 100 / 111  
 Resistivity (ohm-cm): B (0.0005 ~ >1000)  
 Red P (0.0009 ~ 0.0015)  
 P (1 ~ 100)  
 As (0.0018 ~ 0.007)  
 Sb (0.007 ~ 0.02)  
 Wafer Size (mm): 100 / 125 / 150 / 200 / 300

## DSP Wafer

Dopant: B / P / As / Sb  
 Orientation: 100 / 111  
 Resistivity (ohm-cm): 0.0005 ~ >1000  
 TTV (um): <=1  
 Wafer Size (mm): 150 / 200 / 300

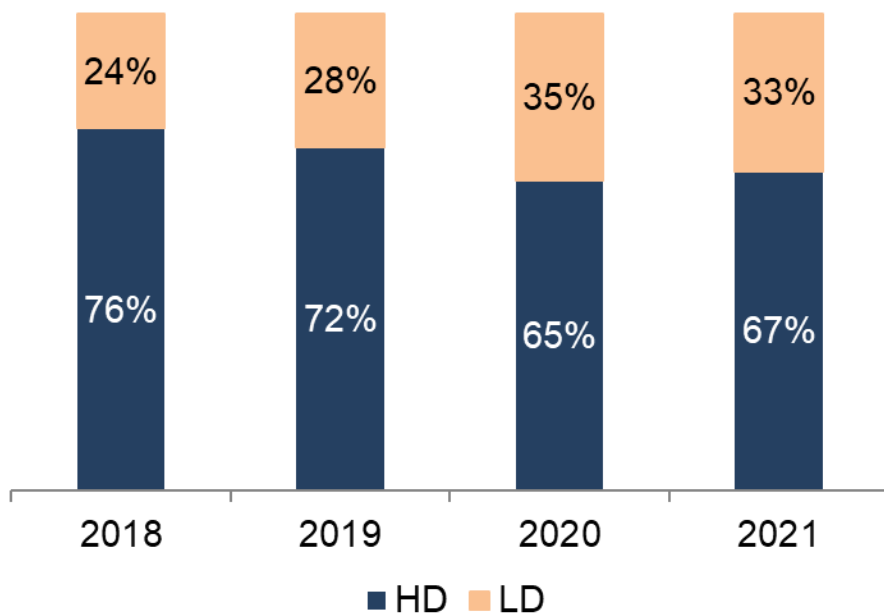
## SOI Wafer

Dopant: B / P / As / Sb  
 Orientation: 100 / 111  
 Resistivity (ohm-cm): 0.0009 ~ >1000  
 SOI Layer (um): >1.5  
 Tolerance (um): +/-0.15  
 Buried Oxide (um): 0.1~5  
 Wafer Size (mm): 150 / 200

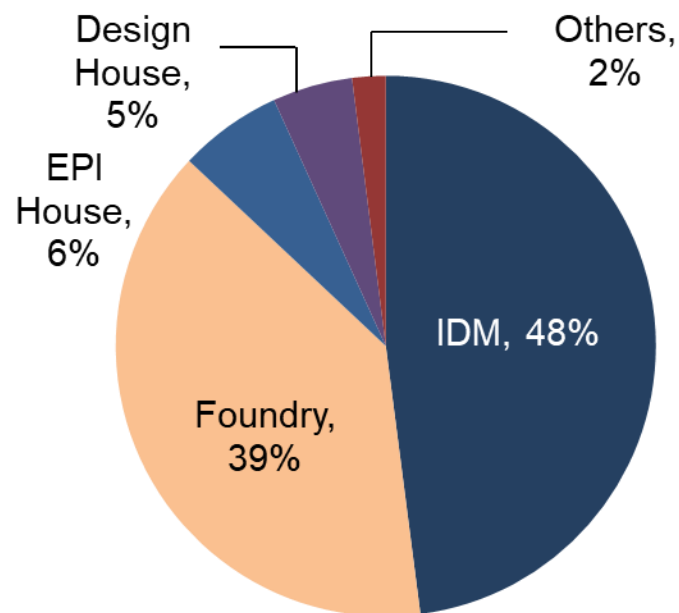
# 市場定位及客戶組成

- 專注於功率元件用的重摻晶圓產品，佔年度營收超過6成
- 營收與車用市場連動性強
- 客戶以整合元件製造商與晶圓代工業者為主，佔年營收近8成
- 客戶分佈台灣、歐美及中國大陸各佔1/3

合晶重摻營收占比



營收客戶別占比





# 全球主要客戶分佈

Sales Force



IDM

Foundry

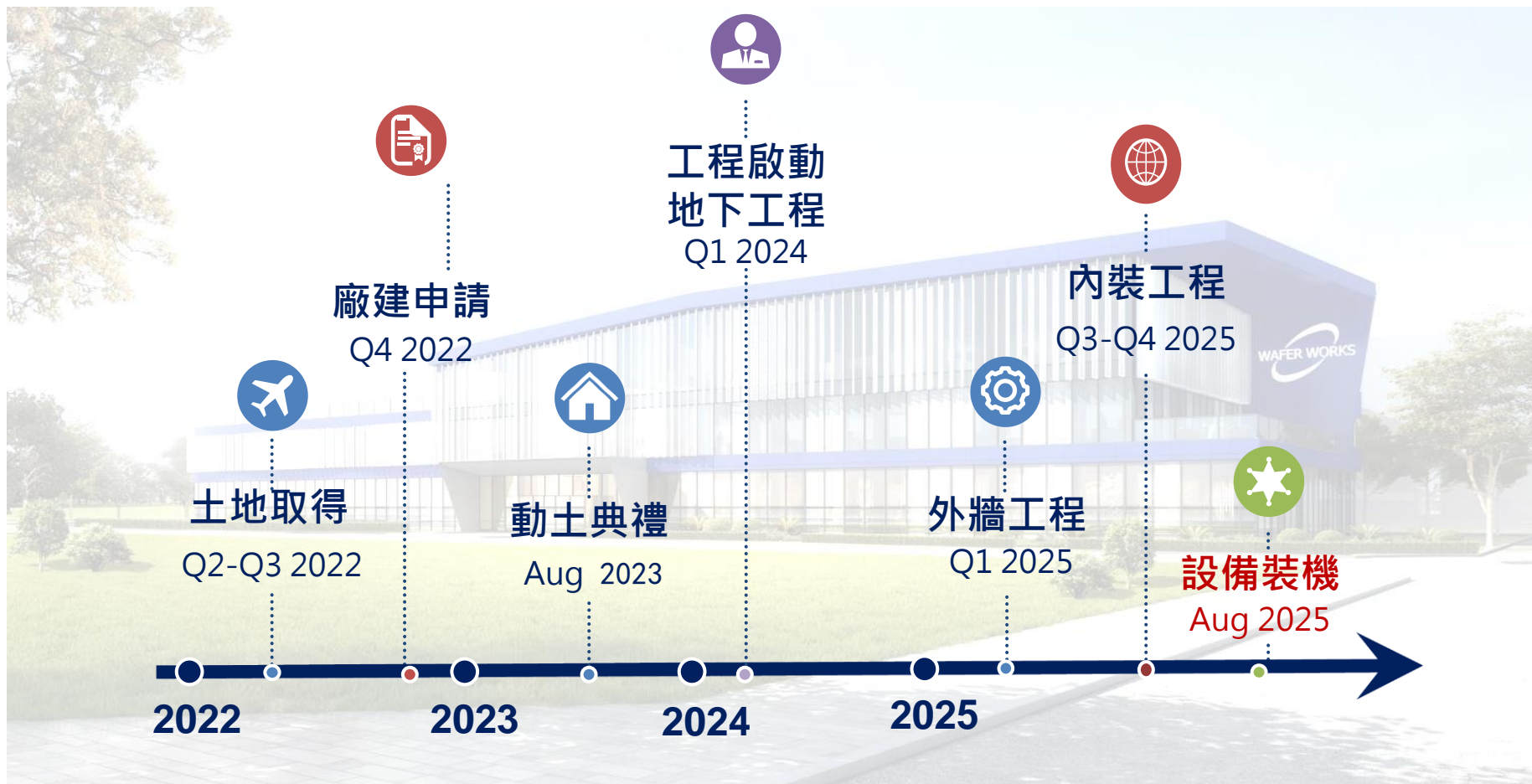
Logos of Independent Die Manufacturer (IDM) customers:

- TEXAS INSTRUMENTS
- Infineon
- NXP
- ST life.augmented
- RENESAS
- onsemi.
- FUJIFILM Value from Innovation
- DIODES INCORPORATED
- silex MICROSYSTEMS
- VISHAY

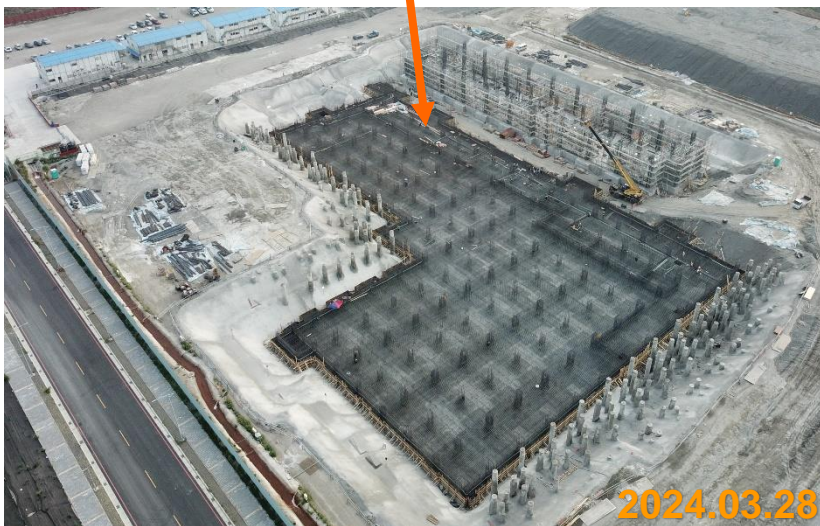
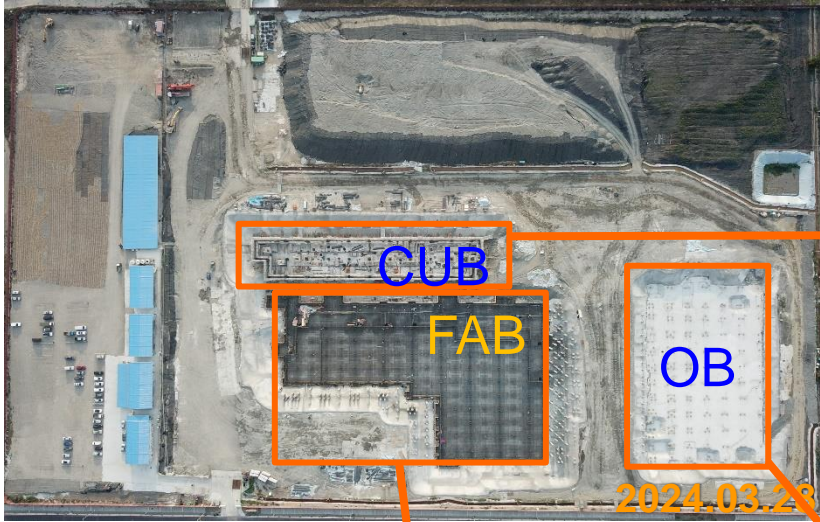
Logos of Foundry customers:

- tsmc
- UMC
- VIS
- TOWERJAZZ The Global Specialty Foundry Leader
- PSMC
- SMIC
- GLOBAL FOUNDRIES

# 12吋矽晶圓發展計畫： 中科二林廠建廠時程



# 二林廠施工：全區空拍 (2024/3)



# 職缺需求

職務名稱	工作內容	需求條件
製程工程師 製程輪班副工程師	<ol style="list-style-type: none"> <li>負責製程管制及改善。</li> <li>負責提升製程良率。</li> <li>新產品測試生產管理。</li> <li>線上製程參數檢點與稽核。</li> <li>機台基本的調機與排除異常。</li> </ol>	材料、化學、化工、電機、電子等相關科系 大學或碩士畢
製程研發替代役	<ol style="list-style-type: none"> <li>執行良率維持與改善。</li> <li>執行產能提升專案。</li> <li>執行品質改善專案。</li> <li>執行成本降低專案。</li> </ol>	材料工程、化學工程、電機、電子等相關科系 碩士畢
設備工程師 設備輪班副工程師	<ol style="list-style-type: none"> <li>矽晶圓設備機台維護及效能精進。</li> <li>計畫和執行分析等改善專案。</li> <li>建立新設備所需規範作為採購及系統需求之依據。</li> </ol>	材料、化學、化工、電機、電子機械等相關科系 大學或碩士畢
廠務輪班副工程師	<ol style="list-style-type: none"> <li>維持廠務系統正常運作。</li> <li>保養維護及異常處置。</li> <li>系統改善與擴建專案等執行。</li> </ol>	電機、電子、機械等相關科系 大學以上

